

Nos systèmes interviennent dans la réalisation de pièces complètes ou pour des opérations de sous-traitance de micro-usinage sur des pièces en cours de fabrication dans vos ateliers.

Nous réalisons différentes opérations de micro-usinage de qualité sans contact dans tous les matériaux conducteurs ou isolants de faibles épaisseurs.

- Perçage et micro-perçage traversant ou borgne (diamètre de 20 $\mu$ m à plusieurs dizaines de mm )
- Détourage et micro découpe de formes complexes avec rayons de courbure inférieurs à 20 $\mu$ m (contour de pièces, pièces complètes, isolement de pistes de C.I. ...)
- Nettoyage de zones polluées (retrait de vernis, de zones de masquages...)
- Retrait de matière avec contrôle de la profondeur
- Marquage et gravure permanents visibles ou invisibles, (logos, numéros de séries, protection de propriétés ...).
  
- Découpe de pochoirs (stencils)...

Que votre secteur d'activités soit l'industrie électronique, la recherche, le médical, la mécanique, l'horlogerie etc .. les opérations de micro usinage par Laser sont une solution à la réalisation de nouveaux produits. L'équipe de M.U.L. met à votre disposition son expérience unique des technologies LASER Y.A.G. UV et du micro-usinage par LASER.

[Télécharger notre brochure ici](#)

